

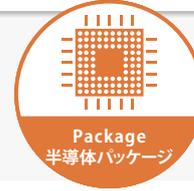
For power modules high thermal conductive semiconductor encapsulation materials

パワーモジュール用 高熱伝導封止材



Applications 用途

Automotive module, Inverter module for major appliances and industrial motors
 車載用モジュール、白物家電・産業モーター用インバータモジュール



Achieving high mountability and high heat dissipation (Package warpage control)

Suitable for large packages with heat spreaders exposed (T/C resistance improvement due to stress reduction)

Compatible with nickel plating (Achieved high adhesion)

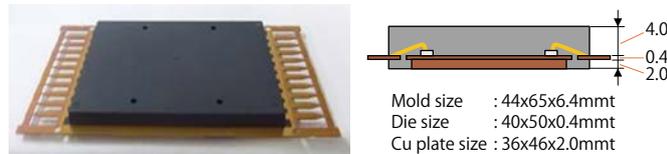
高実装性、高放熱性対応（パッケージ反りコントロール）、大型、ヒートスプレッダ露出パッケージ対応（低応力化による耐 T/C 性向上）、ニッケルメッキ対応（高密着化の実現）

High heat dissipation
高放熱性

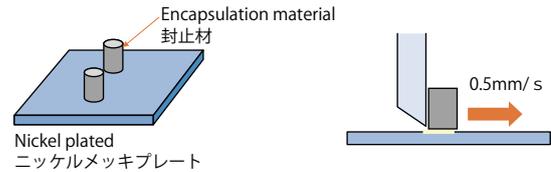
Stress reduction
低応力化

High adhesion
高密着

■ Stress reduction: Thermal cycle (T/C) resistance
低応力化: 耐ヒートサイクル(T/C) 性

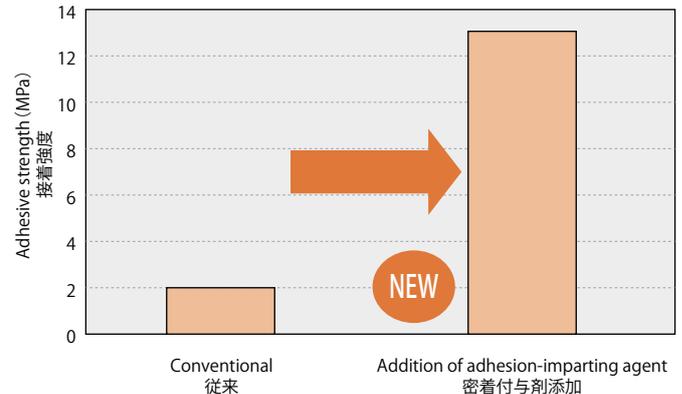


■ Nickel plating adhesion: Shear adhesive strength
ニッケルメッキ密着性: せん断密着力



SAT image after TC -50°C (30 min) ⇔ +150°C (30 min)

	After cure アフターキュア	100 cycles	300 cycles	500 cycles
Ref E=20GPa				
New E=14GPa				



■ Line-up ラインアップ

Part Number 品番	Applications 用途	Features 特長
CV3300 / CV4380	Encapsulation of fully-molded module フルモールドモジュール封止	High thermal conductive grade (1.7~2.3 W/mK) 高熱伝導グレード
CV4500 / CV4580		Super high thermal conductive grade (3.0~3.5 W/mK) 超高熱伝導グレード
CV4100A/CV4180A	Encapsulation of module with heat spreader exposed ヒートスプレッダ露出タイプ モジュール封止	Low stress type for metallic substrates 金属基板用 低応力タイプ
CV4100B / CV4180B		Low stress type for ceramic substrates セラミック基板用 低応力タイプ

The above data are typical values and not guaranteed values. 上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。